

深圳清溢光电股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●每10股派发现金红利人民币0.60元(含税)。公司本年度不派送红股，不进行转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

经财务负责人(财务总监)和董事会秘书(财务负责人)于2022年4月20日召开的第九届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意将利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案
(一)董事会审议情况
(二)监事会意见
(三)独立董事意见

二、风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
(二)其他风险提示

深圳清溢光电股份有限公司 董事会 2022年4月22日

深圳清溢光电股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.secdisc.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示
3.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

4.公司利润分配预案
5.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

6.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

7.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

8.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

9.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

10.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

11.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

12.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

13.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

14.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

15.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

16.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

17.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

18.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

19.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

20.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

21.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

22.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

23.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

24.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

25.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

26.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

27.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

28.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

29.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

30.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

31.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

32.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

33.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

34.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

35.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

36.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

37.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

38.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

39.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

40.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

41.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

42.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

43.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

44.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

45.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

46.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

47.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

48.本报告涉及的未来计划等前瞻性内容，投资者在阅读“第三节管理层讨论与分析”四、风险因素”中关于未来计划等前瞻性内容。

半导体芯片行业作为半导体行业的主要代表，是整个电子信息产业的基础，中国大陆半导体自给率水平非常低，特别是核心芯片极度缺乏。

未来，半导体芯片产能将进一步向中国大转移，在智能汽车、人工智能、存储设备、物联网、5G通信、元宇宙等领域迎来爆发式增长，中国半导体行业将迎来新一轮的发展高潮。

SEMI预计从2021年9月到2024年，对于新建的300mm和400mm晶圆厂，将有25家8英寸(200mm)晶圆厂投入运营，其中19家在亚洲(中国大陆14家、日本3家和台湾中国台湾2家)、5家位于美国和1家位于欧洲/中东。预计2020年至2024年200mm晶圆的产能将增加18%。

除上述之外，新增扩产300mm晶圆厂约60家，细分为44家在亚洲(其中，中国大陆和中国台湾地区分别为15家、韩国8家、日本5家、新加坡1家)、10家在美国和6家在欧洲。中国半导体行业产能提升将带动全球半导体行业产能提升。

根据Yole的研究，随着全球特定“碳达峰、碳中和”目标，带来更多绿色能源发电、绿色汽车、充电桩、储能等领域，使得中国IC产业中的企业提高产能，截至2026年可用市场规模将超过250亿美元，2020年至2026年CAGR为3.0%。汽车和工业两个应用市场增长最快，2020年至2026年的CAGR分别为9.0%和5.6%，消费电子将是最大的细分市场，预期至2026年将超越工业及消费电子的总营收。

在工业和消费电子领域，MEMS行业细分领域包括MEMS惯性传感器、压力传感器、MEMS麦克风等发展势头强劲。根据Yole预测，全球MEMS行业市场规模将在2020年的121亿美元增长至2026年的约182亿美元，CAGR达7.2%。MEMS行业将带动半导体芯片封装的需求进一步增长。

1) 在消费电子领域，随着5G手机、智能电视、智能音箱、智能手表、智能手环、智能眼镜、智能汽车等消费电子产品的普及，带动消费电子芯片封装需求的增长。二是消费电子芯片封装需求的增长，带动消费电子芯片封装需求的增长。

2) 在工业领域，随着工业4.0、智能制造、工业互联网等应用的普及，带动工业芯片封装需求的增长。三是工业芯片封装需求的增长，带动工业芯片封装需求的增长。

3) 在汽车领域，随着新能源汽车的普及，带动汽车芯片封装需求的增长。四是汽车芯片封装需求的增长，带动汽车芯片封装需求的增长。

4) 在医疗设备领域，随着医疗设备的普及，带动医疗设备芯片封装需求的增长。五是医疗设备芯片封装需求的增长，带动医疗设备芯片封装需求的增长。

5) 在航空航天领域，随着航空航天产业的普及，带动航空航天芯片封装需求的增长。六是航空航天芯片封装需求的增长，带动航空航天芯片封装需求的增长。

6) 在国防军工领域，随着国防军工产业的普及，带动国防军工芯片封装需求的增长。七是国防军工芯片封装需求的增长，带动国防军工芯片封装需求的增长。

7) 在海洋工程领域，随着海洋工程的普及，带动海洋工程芯片封装需求的增长。八是海洋工程芯片封装需求的增长，带动海洋工程芯片封装需求的增长。

8) 在能源领域，随着能源产业的普及，带动能源芯片封装需求的增长。九是能源芯片封装需求的增长，带动能源芯片封装需求的增长。

9) 在环保领域，随着环保产业的普及，带动环保芯片封装需求的增长。十是环保芯片封装需求的增长，带动环保芯片封装需求的增长。

10) 在农业领域，随着农业产业的普及，带动农业芯片封装需求的增长。十一是农业芯片封装需求的增长，带动农业芯片封装需求的增长。

11) 在林业领域，随着林业产业的普及，带动林业芯片封装需求的增长。十二是林业芯片封装需求的增长，带动林业芯片封装需求的增长。

12) 在畜牧业领域，随着畜牧业产业的普及，带动畜牧业芯片封装需求的增长。十三是畜牧业芯片封装需求的增长，带动畜牧业芯片封装需求的增长。

13) 在渔业领域，随着渔业产业的普及，带动渔业芯片封装需求的增长。十四是渔业芯片封装需求的增长，带动渔业芯片封装需求的增长。

14) 在采矿业领域，随着采矿业的普及，带动采矿芯片封装需求的增长。十五是采矿芯片封装需求的增长，带动采矿芯片封装需求的增长。

15) 在制造业领域，随着制造业的普及，带动制造芯片封装需求的增长。十六是制造芯片封装需求的增长，带动制造芯片封装需求的增长。

16) 在服务业领域，随着服务业的普及，带动服务芯片封装需求的增长。十七是服务芯片封装需求的增长，带动服务芯片封装需求的增长。

17) 在金融业领域，随着金融业的普及，带动金融芯片封装需求的增长。十八是金融芯片封装需求的增长，带动金融芯片封装需求的增长。

18) 在房地产业领域，随着房地产业的普及，带动房地芯片封装需求的增长。十九是房地芯片封装需求的增长，带动房地芯片封装需求的增长。

19) 在文化娱乐领域，随着文化娱乐产业的普及，带动文化娱乐芯片封装需求的增长。二十是文化娱乐芯片封装需求的增长，带动文化娱乐芯片封装需求的增长。

20) 在体育领域，随着体育产业的普及，带动体育芯片封装需求的增长。二十一是在体育芯片封装需求的增长，带动体育芯片封装需求的增长。

21) 在旅游领域，随着旅游产业的普及，带动旅游芯片封装需求的增长。二十二是在旅游芯片封装需求的增长，带动旅游芯片封装需求的增长。

22) 在餐饮领域，随着餐饮产业的普及，带动餐饮芯片封装需求的增长。二十三是在餐饮芯片封装需求的增长，带动餐饮芯片封装需求的增长。

23) 在零售领域，随着零售产业的普及，带动零售芯片封装需求的增长。二十四是在零售芯片封装需求的增长，带动零售芯片封装需求的增长。

24) 在批发领域，随着批发产业的普及，带动批发芯片封装需求的增长。二十五是在批发芯片封装需求的增长，带动批发芯片封装需求的增长。

25) 在进出口贸易领域，随着进出口贸易产业的普及，带动进出口贸易芯片封装需求的增长。二十六是在进出口贸易芯片封装需求的增长，带动进出口贸易芯片封装需求的增长。

26) 在物流运输领域，随着物流运输产业的普及，带动物流运输芯片封装需求的增长。二十七是在物流运输芯片封装需求的增长，带动物流运输芯片封装需求的增长。

27) 在仓储领域，随着仓储产业的普及，带动仓储芯片封装需求的增长。二十八是在仓储芯片封装需求的增长，带动仓储芯片封装需求的增长。

28) 在信息传输领域，随着信息传输产业的普及，带动信息传输芯片封装需求的增长。二十九是在信息传输芯片封装需求的增长，带动信息传输芯片封装需求的增长。

29) 在计算机及互联网领域，随着计算机及互联网产业的普及，带动计算机及互联网芯片封装需求的增长。三十是在计算机及互联网芯片封装需求的增长，带动计算机及互联网芯片封装需求的增长。

30) 在软件及信息技术服务领域，随着软件及信息技术服务产业的普及，带动软件及信息技术服务芯片封装需求的增长。三十一是在软件及信息技术服务芯片封装需求的增长，带动软件及信息技术服务芯片封装需求的增长。

31) 在咨询及技术服务领域，随着咨询及技术服务产业的普及，带动咨询及技术服务芯片封装需求的增长。三十二是在咨询及技术服务芯片封装需求的增长，带动咨询及技术服务芯片封装需求的增长。

32) 在广告及营销领域，随着广告及营销产业的普及，带动广告及营销芯片封装需求的增长。三十三是在广告及营销芯片封装需求的增长，带动广告及营销芯片封装需求的增长。

33) 在公关及品牌管理领域，随着公关及品牌管理产业的普及，带动公关及品牌管理芯片封装需求的增长。三十四是在公关及品牌管理芯片封装需求的增长，带动公关及品牌管理芯片封装需求的增长。

34) 在人力资源及招聘领域，随着人力资源及招聘产业的普及，带动人力资源及招聘芯片封装需求的增长。三十五是在人力资源及招聘芯片封装需求的增长，带动人力资源及招聘芯片封装需求的增长。

35) 在培训及教育领域，随着培训及教育产业的普及，带动培训及教育芯片封装需求的增长。三十六是在培训及教育芯片封装需求的增长，带动培训及教育芯片封装需求的增长。

36) 在研究与开发领域，随着研究与开发产业的普及，带动研究与开发芯片封装需求的增长。三十七是在研究与开发芯片封装需求的增长，带动研究与开发芯片封装需求的增长。

37) 在测试及认证领域，随着测试及认证产业的普及，带动测试及认证芯片封装需求的增长。三十八是在测试及认证芯片封装需求的增长，带动测试及认证芯片封装需求的增长。

38) 在标准及知识产权领域，随着标准及知识产权产业的普及，带动标准及知识产权芯片封装需求的增长。三十九是在标准及知识产权芯片封装需求的增长，带动标准及知识产权芯片封装需求的增长。

39) 在行业组织及协会领域，随着行业组织及协会产业的普及，带动行业组织及协会芯片封装需求的增长。四十是在行业组织及协会芯片封装需求的增长，带动行业组织及协会芯片封装需求的增长。

40) 在政府事务及公共关系领域，随着政府事务及公共关系产业的普及，带动政府事务及公共关系芯片封装需求的增长。四十一是在政府事务及公共关系芯片封装需求的增长，带动政府事务及公共关系芯片封装需求的增长。

季度投资者关系活动记录摘要
□适用 √不适用

4. 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户) and 11,351

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

深圳清溢光电股份有限公司 关于2022年度预计日常关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易协议签署情况
(二)日常关联交易协议主要内容

二、关联方基本情况
(一)关联方基本情况
(二)关联方关系图

三、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序

四、关联交易对公司的影响
(一)对公司经营业绩的影响

五、关联交易定价政策
(一)定价政策

六、关联交易决策程序
(一)决策程序

七、关联交易信息披露
(一)信息披露

八、关联交易风险提示
(一)风险提示

九、关联交易其他事项
(一)其他事项

十、关联交易其他事项
(一)其他事项

十一、关联交易其他事项
(一)其他事项

十二、关联交易其他事项
(一)其他事项

十三、关联交易其他事项
(一)其他事项

十四、关联交易其他事项
(一)其他事项

十五、关联交易其他事项
(一)其他事项

十六、关联交易其他事项
(一)其他事项

十七、关联交易其他事项
(一)其他事项

十八、关联交易其他事项
(一)其他事项

十九、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十一、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十二、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十三、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十四、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十五、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十六、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十七、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十八、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十九、关联交易其他事项
(一)其他事项

三十、关联交易其他事项
(一)其他事项

三十一、关联交易其他事项
(一)其他事项

三十二、关联交易其他事项
(一)其他事项

三十三、关联交易其他事项
(一)其他事项

关于2022年度预计日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易协议签署情况
(二)日常关联交易协议主要内容

二、关联方基本情况
(一)关联方基本情况
(二)关联方关系图

三、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序

四、关联交易对公司的影响
(一)对公司经营业绩的影响

五、关联交易定价政策
(一)定价政策

六、关联交易决策程序
(一)决策程序

七、关联交易信息披露
(一)信息披露

八、关联交易风险提示
(一)风险提示

九、关联交易其他事项
(一)其他事项

十、关联交易其他事项
(一)其他事项

十一、关联交易其他事项
(一)其他事项

十二、关联交易其他事项
(一)其他事项

十三、关联交易其他事项
(一)其他事项

十四、关联交易其他事项
(一)其他事项

十五、关联交易其他事项
(一)其他事项

十六、关联交易其他事项
(一)其他事项

十七、关联交易其他事项
(一)其他事项

十八、关联交易其他事项
(一)其他事项

十九、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十一、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十二、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十三、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十四、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十五、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十六、关联交易其他事项
(一)其他事项

二十七、关联交易其他事项
(一)其他事项